

SID

Werk: Rot am See

Artikel: 333483 ML4

Erstellt: NIES

Kunde: AV RT

Datum: 24.01.2013



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG135	50200534	205		2	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG135	50200534	0		3	
A-RS-FR4-ML-0.25mm-035+035-TG135	50200296	35	L2	4	
		250			
		35	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG135	50200534	205		5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG135	50200534	0		6	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	7	

Dicke nach Verpressen	B00: 660 µm	Tol+: 100 µm	Tol-: 100 µm	Dmax: 760 µm	Dmin: 560 µm
Gesamtdicke über alles	0 µm	Tol+: 0 µm	Tol-: 0 µm	Dmax: 0 µm	Dmin: 0 µm
Kundenforderung	Dicke (D): 800 µm	Tol+: 100 µm	Tol-: 100 µm	Dmax: 900 µm	Dmin: 700 µm
	Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig				

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML4

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		2	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		3	
A-RS FR4 0.51mm 035+035	50200346	35	L2	4	
		510			
		35	L3		
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		5	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		6	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	7	

Dicke nach Verpressen B00: 860 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 960 µm Dmin: 760 µm

Gesamtdicke über alles 0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung Dicke (D): 1000 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 1100 µm Dmin: 900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig 862 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML4

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS Prepreg-2116	50200534	288		2	
A-RS Prepreg-7628	50200465	0		3	
A-RS FR4 0.71mm 035+035	50200375	35	L2	4	
		730			
		35	L3		
A-RS Prepreg-7628	50200465	288		5	
A-RS Prepreg-2116	50200534	0		6	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	7	

Dicke nach Verpressen

B00: 1410 µm Tol+: 155 µm Tol-: 155 µm Dmax: 1565 µm Dmin: 1255 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 1550 µm Tol+: 155 µm Tol-: 155 µm Dmax: 1705 µm Dmin: 1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig 1412 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML4

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS Prepreg-7628	50200465	363		2	
A-RS Prepreg-7628	50200465	0		3	
A-RS FR4 1.55mm 035+035	50200106	35	L2	4	
		1480 00	L3		
A-RS Prepreg-7628	50200465	363		5	
A-RS Prepreg-7628	50200465	0		6	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	7	

Dicke nach Verpressen

B00: 2260 µm Tol+: 240 µm Tol-: 240 µm Dmax: 2500 µm Dmin: 2020 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 2400 µm Tol+: 240 µm Tol-: 240 µm Dmax: 2640 µm Dmin: 2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig 2512,00 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML6

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	B00
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		2	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		3	
		35	L2	4	
A-RS FR4 0.20mm 035+035	50200287	205	L3	5	
		35		6	
A-RS Prepreg-1080	50200442	105		7	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		8	
A-RS FR4 0.20mm 035+035	50200287	205	L4	9	
		35	L5	10	
A-RS Prepreg-1080	50200442	123			
A-RS Prepreg-1080	50200442	0			
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS		

Dicke nach Verpressen	B00: <input type="text"/> 910 µm	Tol+: <input type="text"/> 105 µm	Tol-: <input type="text"/> 105 µm	Dmax: <input type="text"/> 1015 µm	Dmin: <input type="text"/> 805 µm
Gesamtdicke über alles	<input type="text"/> 0 µm	Tol+: <input type="text"/> 0 µm	Tol-: <input type="text"/> 0 µm	Dmax: <input type="text"/> 0 µm	Dmin: <input type="text"/> 0 µm
Kundenforderung	Dicke (D): <input type="text"/> 1050 µm	Tol+: <input type="text"/> 105 µm	Tol-: <input type="text"/> 105 µm	Dmax: <input type="text"/> 1155 µm	Dmin: <input type="text"/> 945 µm
	Messstelle: <input type="text"/> (05) über LM und galv.Cu; beidseitig				<input type="text"/> 937 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML6

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	B00
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		2	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		3	
		35	L2	4	
A-RS FR4 0.41mm 035+035	50200329	395	L3	5	
		35		6	
A-RS Prepreg-2116	50200534	195		7	
A-RS Prepreg-2116	50200534	0		8	
A-RS FR4 0.41mm 035+035	50200329	395	L4	9	
		35	L5	10	
A-RS Prepreg-1080	50200442	123			
A-RS Prepreg-1080	50200442	0			
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS		

Dicke nach Verpressen	B00:	<input type="text"/> 1410 µm	Tol+:	<input type="text"/> 155 µm	Tol-:	<input type="text"/> 155 µm	Dmax:	<input type="text"/> 1565 µm	Dmin:	<input type="text"/> 1255 µm	
Gesamtdicke über alles		<input type="text"/> 0 µm	Tol+:	<input type="text"/> 0 µm	Tol-:	<input type="text"/> 0 µm	Dmax:	<input type="text"/> 0 µm	Dmin:	<input type="text"/> 0 µm	
Kundenforderung	Dicke (D):	<input type="text"/> 1550 µm	Tol+:	<input type="text"/> 155 µm	Tol-:	<input type="text"/> 155 µm	Dmax:	<input type="text"/> 1705 µm	Dmin:	<input type="text"/> 1395 µm	
	Messstelle:	<input type="text"/> (05) über LM und galv.Cu; beidseitig							<input type="text"/> 1407 µm		

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML6

Erstellt:

Kunde:

Datum:



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	B00	
A-RS Prepreg-2116	50200534	213		2		
A-RS Prepreg-2116	50200534	0		3		
		35	L2	4		A00
A-RS FR4 0.71mm 035+035	50200375	730	L3			
		35				
A-RS Prepreg-2116	50200534	195		5		
A-RS Prepreg-2116	50200534	0		6		
		35	L4	7		
A-RS FR4 0.71mm 035+035	50200375	730	L5			
		35				
A-RS Prepreg-2116	50200534	213		8		
A-RS Prepreg-2116	50200534	0		9		
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	10		

Dicke nach Verpressen B00: 2260 µm Tol+: 240 µm Tol-: 240 µm Dmax: 2500 µm Dmin: 2020 µm

Gesamtdicke über alles 0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung Dicke (D): 2400 µm Tol+: 240 µm Tol-: 240 µm Dmax: 2640 µm Dmin: 2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig 2257 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML8

Erstellt:

Kunde: AV RT

Datum:



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		2	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		3	
		35	L2		
A-RS FR4 0.25mm 035+035	50200296	250		4	A01
		35	L3		
A-RS Prepreg-1080	50200442	105		5	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		6	
		35	L4		
A-RS FR4 0.25mm 035+035	50200296	250		7	A02 B00
		35	L5		
A-RS Prepreg-1080	50200442	105		8	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		9	
		35	L6		
A-RS FR4 0.25mm 035+035	50200296	250		10	A03
		35	L7		
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		11	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		12	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	13	

Dicke nach Verpressen	B00: <input type="text"/> 1410 µm	Tol+: <input type="text"/> 155 µm	Tol-: <input type="text"/> 155 µm	Dmax: <input type="text"/> 1565 µm	Dmin: <input type="text"/> 1255 µm
Gesamtdicke über alles	<input type="text"/> 0 µm	Tol+: <input type="text"/> 0 µm	Tol-: <input type="text"/> 0 µm	Dmax: <input type="text"/> 0 µm	Dmin: <input type="text"/> 0 µm
Kundenforderung	Dicke (D): <input type="text"/> 1550 µm	Tol+: <input type="text"/> 155 µm	Tol-: <input type="text"/> 155 µm	Dmax: <input type="text"/> 1705 µm	Dmin: <input type="text"/> 1395 µm
	Messstelle: <input type="text"/> (05) über LM und galv.Cu; beidseitig				<input type="text"/> 1452 µm

SID

Stackup Intelligence Designer

Artikel: ML8

Erstellt:

Kunde: AV RT

Datum:



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	VS	1	
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		2	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		3	
		35	L2		
A-RS FR4 0.51mm 035+035	50200346	520		4	A01
		35	L3		
A-RS Prepreg-1080	50200442	105		5	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		6	
		35	L4		
A-RS FR4 0.51mm 035+035	50200346	520		7	A02 B00
		35	L5		
A-RS Prepreg-1080	50200442	105		8	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		9	
		35	L6		
A-RS FR4 0.51mm 035+035	50200346	520		10	A03
		35	L7		
A-RS Prepreg-1080	50200442	123		11	
A-RS Prepreg-1080	50200442	0		12	
A-RS Kupferfolie-018my 335x490mm	50200238	18	RS	13	

Dicke nach Verpressen	B00: <input type="text"/> 2260 µm	Tol+: <input type="text"/> 240 µm	Tol-: <input type="text"/> 240 µm	Dmax: <input type="text"/> 2500 µm	Dmin: <input type="text"/> 2020 µm
Gesamtdicke über alles	<input type="text"/> 0 µm	Tol+: <input type="text"/> 0 µm	Tol-: <input type="text"/> 0 µm	Dmax: <input type="text"/> 0 µm	Dmin: <input type="text"/> 0 µm
Kundenforderung	Dicke (D): <input type="text"/> 2400 µm	Tol+: <input type="text"/> 240 µm	Tol-: <input type="text"/> 240 µm	Dmax: <input type="text"/> 2640 µm	Dmin: <input type="text"/> 2160 µm
	Messstelle: <input type="text"/> (05) über LM und galv.Cu; beidseitig				<input type="text"/> 2262 µm